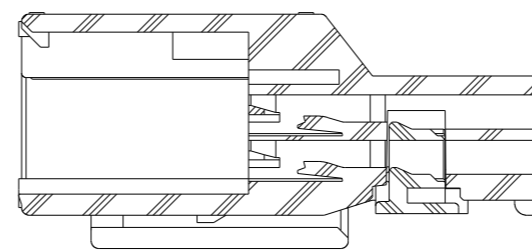


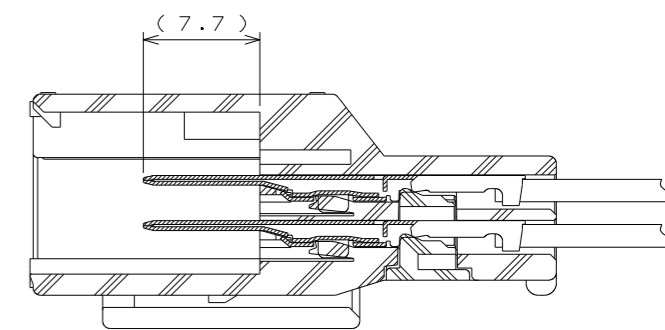
版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	21.Oct.2008	066693	ADDED TERMINAL MATERIALS PLATING LIST		Y.WATANABE	K.MIYAMOTO	T.MORINO
3	14.Nov.2008	066892	CHANGE OF TERMINAL MATERIALS PLATING LIST		Y.WATANABE	K.MIYAMOTO	T.KUME
4	4.Apr.2017	020903	DRAWING CORRECTION		S.TAKIZAWA	Y.YAMAMOTO	K.KAWASE

TABLE1: TERMINAL MATERIALS AND PLATING LIST (端子材料・メッキ設定コード表)

CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M34P75C4F1	103146	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY 高導電性銅合金	TIN PLATING スズめっき	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
M	M34P75C4F2	103147			CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFUS 0.75sq. CHFUS 0.75sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
X	M34P75C4F5	109337			CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応

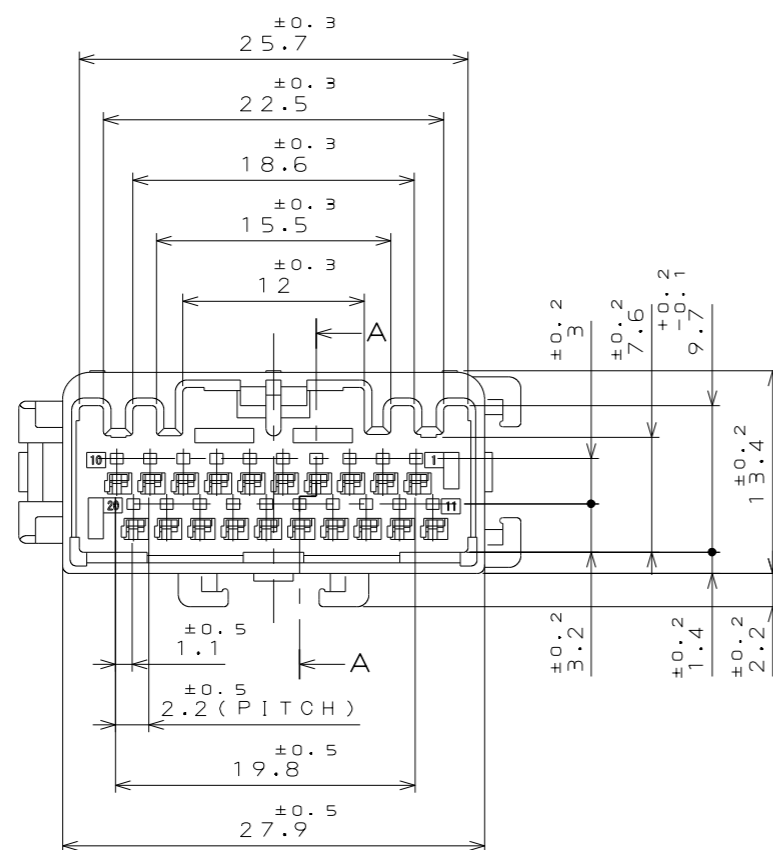
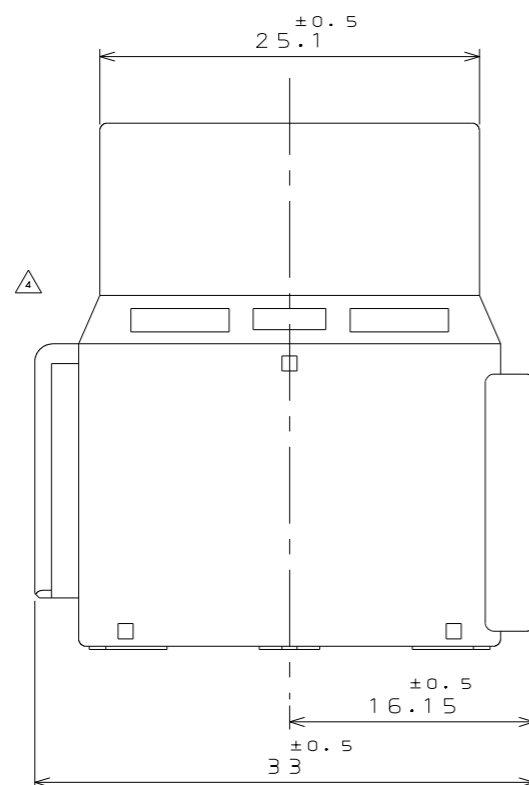


S E C T. A - A



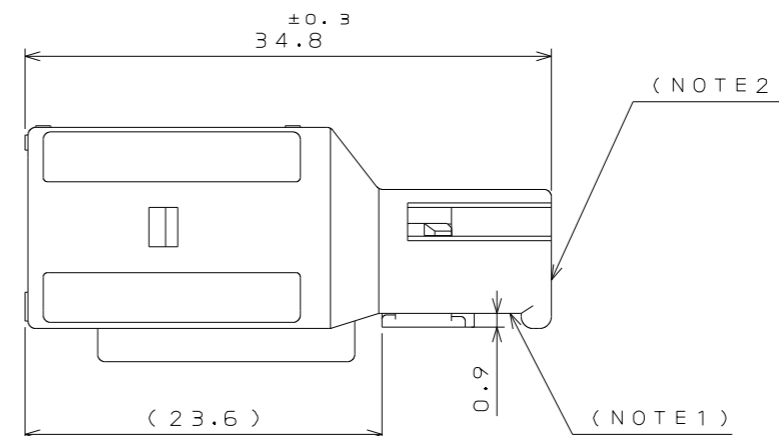
PREMATED CONDITION (REF)



嵌合前状态图(参考)



NOTE1.COMPANY LOGO "JAE",MOLD CAVITY DESIGNATOR  
AND MATERIAL MARKS ">PPE+PA66<" IS INDICATED AS SHOWN.  
2.POTISION NO. IS INDICATED AS SHOWN.

注1.図示の位置に社標、金型マーク、材料名の表示する。  
2.図示の位置に端子No.を表示する。



2	RETAINER	1	PPE+PA66(ALLY)	_____	COLOR:BLACK	A3 SIZE S
1	HOUSING	1	PPE+PA66(ALLY)	_____	COLOR:GRAY	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ104399 版数 (VER.) 4
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 18.Mar.2005		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX34	
△ JACS-1754-4 J A H L - 1 7 5 4 - 1		製図 DR.		名称 (TITLE) MX3402OPF1		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	T.NAKAYA			
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	N.TOUDOU		
・ ±0.8	×° ±	承認 APPD.	T.ISHIWA	質量 (MASS) 5.9 g		
・× ±0.4	×°× ±	単位 (UNIT): mm				
・×× ±0.1						
・××× ±						

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.  
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.